

(11)Publication number:

2000-261193

(43) Date of publication of application: 22.09.2000

(51)Int.CI.

H05K 13/02

(21)Application number: 11-108367

(71)Applicant: MISUZU KOGYO:KK

(22)Date of filing:

11.03.1999

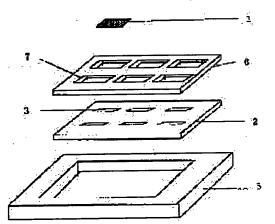
(72)Inventor: IWASA KAZUHIRO

(54) METHOD OF FIXING FPC BOARD TO CARRIER BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of fixing a flexible printed circuit(FPC) board to a carrier board whereby the FPC board can be exactly aligned and easily removed from the carrier board in a few processes, without an exclusive carrier board of every type, and adhesive tapes are reusable.

SOLUTION: The method comprises steps of pasting to a carrier board 2 a plurality of rows of higher-adhesive surfaces of double-sided tapes 3 each having coatings of adhesives different in adhesion on both surfaces of a base, mounting the carrier board 2 with the adhered tapes 3 on a positioning guide plate 5, mounting a board positioning jig 6 on the guide board 5, and inserting the FPC board 1 into a positioning hole 7 of the positioning jig 6 to rigidly fix it to the lower-adhesive surface of each tape 3. The adhesive of the lower- adhesive surface of the tape 3 is of a silicone material and that of the higher- adhesive surface is of an acrylic material.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.07.2002 02.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-261193 (P2000-261193A)

(43)公開日 平成12年9月22日(2000.9.22)

(51) Int.Cl.7

H05K 13/02

費別割号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H 0 5 K 13/02

V 5E313

審査請求 未請求 請求項の数2 書面 (全 3 頁)

(21)出顯番号

特篇平11-108367

(22) 出顧日

平成11年3月11日(1999.3.11)

(71)出願人 591093494

株式会社ミスズ工業

長野県諏訪市大字四賀3090番地

(72)発明者 岩佐 和弘

長野県諏訪市大字四賀3090番地 株式会社

ミスズ工業内

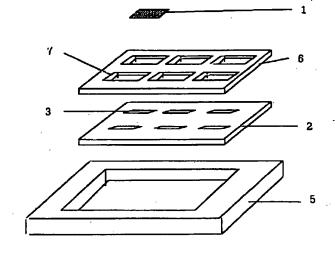
Fターム(参考) 5E313 AA12 CC05 DD13

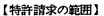
# (54) 【発明の名称】 搬送板へのFPC基板固着方法

### (57)【要約】

【目的】少ない工程でFPC基板の位置合わせが精度良くでき、種別ごとに専用の搬送板を必要とせず、搬送板からFPC基板の取り外しも容易にでき、しかも粘着テープの再使用が可能な搬送板へのFPC基板固着方法を提供する。

【構成】基材の両面に粘着性の異なる粘着剤を塗付し剥離紙を貼付した両面テープの高粘着性側を搬送板に複数列貼付する工程と、両面テープが貼付された搬送板を位置決め案内板に装着する工程と、位置決め案内板に基板位置決め治具を装着する工程と、基板位置決め治具の位置決め孔にFPC基板を挿入させ両面テープの低粘着性側に固着させる工程とを有してなり、両面テープの低粘着性側の粘着剤はシリコン系よりなり、高粘着性側の粘着剤はアクリル系よりなる。





【請求項1】本発明は、FPC基板(1)を搬送板

(2)に固定する方法において、基材(12)の両面に 粘着性の異なる粘着剤を塗付し剥離紙(4)を貼付した 両面テープ(3)の高粘着性側を前記搬送板に複数列貼 付する工程と、前記両面テープが貼付された搬送板を位 置決め案内板(5)に装着する工程と、前記位置決め案 内板に基板位置決め治具(6)を装着する工程と、前記 基板位置決め治具の位置決め孔(7)にFPC基板

(1)を挿入させ前記両面テープの低粘着性側に固着させる工程とを有してなることを特徴とする搬送板へのF PC基板固着方法。

【請求項2】前記両面テープの低粘着性側の粘着剤はシリコン系よりなり、高粘着性側の粘着剤はアクリル系よりなることを特徴とする請求項1記載の搬送板へのFP C基板固着方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フレキシブルプリント 基板(以下FPC基板という)を搬送板に固定する搬送 板へのFPC基板固着方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来から、FPC基板を搬送板に固定さ せる方法として、予め搬送板に位置合わせ線を引き、そ の線に合わせてFPC基板を置き、その表面に粘着テー プを貼り付けて搬送板に位置決め固定する第1の方法 と、FPC基板に位置決め穴をあけておき、搬送板に設 けた位置決めピンにFPC基板を嵌め込んで位置決め固 定する第2の方法とが知られている。従来の第1の方法 では、FPC基板を搬送板に位置合わせして仮置きし、 搬送板の表面に粘着テープを貼り付けるために位置合わ せに時間がかかっていた。また、FPC基板が薄いため に変形し易くたわみによる浮きが発生し精度良い位置合 わせができない。その上、貼り付け後に粘着テープを剥 がすと剥がした粘着テープはカールしてしまい再使用が できず使い捨てになってしまう。さらに、粘着テープの 粘着力が高いためにFPC基板を搬送板より取り外すの に多くの時間を必要とするなどの問題点があった。従来 の第2の方法では、FPC基板にあけた位置決め穴と搬 送板に設けた位置決めピンとは1対1で対応させておく 必要があり、そのためにFPC基板の種別ごとに専用の 搬送板を用意しておく必要がある。また、FPC基板に たわみなどがある時には浮きが発生し精度良い位置合わ せができない。その上、FPC基板への半田クリーム印 刷をする時には搬送板の位置決めピンがじゃまになり、 密着印刷ができないなどの問題点を有していた。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述の問題 点を解決させるためになされたもので、少ない工程でF PC基板の位置合わせが精度良くでき、種別ごとに専用 の搬送板を必要とせず、搬送板からFPC基板の取り外 しも容易にでき、しかも粘着テープの再使用が可能な搬 送板へのFPC基板固着方法を提供することを目的とす るものである。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明による搬送板への FPC基板固着方法は、FPC基板を搬送板に固定する 方法において、基材の両面に粘着性の異なる粘着剤を塗 付し剥離紙を貼付した両面テープの高粘着性側を前記搬 送板に複数列貼付する工程と、両面テープが貼付された 搬送板を位置決め案内板に装着する工程と、位置決め案 内板に基板位置決め治具を装着する工程と、基板位置決 め治具の位置決め孔にFPC基板を挿入させ両面テープ の低粘着性側に固着させる工程とを有してなり、両面テープの低粘着性側の粘着剤はシリコン系よりなり、高粘 着性側の粘着剤はアクリル系よりなる。

# [0005]

【作用】搬送板に粘着性の異なる粘着剤を塗付した両面テープを複数列に貼付することにより、高粘着性側は高い粘着力により搬送板に確実に固着される。FPC基板は基板位置決め治具により基板の位置精度も良く位置決めでき、剥離性と再粘着性の良い低粘着性側に固着されるので、FPC基板を変形、損傷させることなく容易に剥離させることができると共に両面テープの再使用が可能となる。これにより、FPC基板の種別ごとに専用の搬送板を用意する必要もなく、また、FPC基板に位置決め用の穴を設ける必要もなく、搬送板へのFPC基板固着ができると共に両面テープの繰り返し使用が可能となることから消耗品の節減と工数削減ができるので、製造コストを大幅に低減させることができる。

#### [0006]

【実施例】本発明による搬送板へのFPC基板固着方法 の実施例を図面に基づいて説明する。図1は、本発明に よる搬送板へのFPC基板固着方法の工程を示す説明図 であり、図2は、本発明の実施例における両面テープの 構成図である。図1において、1はFPC基板、2は搬 送板、3は両面に粘着性の異なる粘着材が塗付され搬送 板2に固着される両面テープ、5は搬送板2が装着され る位置決め案内板、6は搬送板2と共に位置決め案内板 5に装着される基板位置決め治具、7は所定の数の挿入 穴が配列形成されFPC基板1を位置決めし搬送板に固 定させる基板位置決め孔である。図2において、3は両 面テープ、8は両面テープ3を構成する基材、3aは基 材8の表面に高い粘着力の粘着剤が塗付された高粘着性 側、3 bは基材8の表面に剥離性、再粘着性の粘着剤が 塗付された低粘着性側、4は高粘着性側3aと低粘着性 側3 bの表面に積層貼付される剝離紙である。

【0007】第1の工程では、基材8の両面に粘着性の 異なる粘着材を塗付し剥離紙4を貼付した図2に示すよ うに構成された両面テープ3の高粘着性側3aの剥離紙 を剥がし、予め搬送板2の表面に複数列貼付して両面テープをそれぞれ固着させる。第2の工程では、両面テープ3が固着された搬送板2を位置決め案内板5に設けられた溝内に装着させる。第3の工程では、位置決め案内板5に装着された搬送板2に重ねて基板位置決め孔7が設けられた基板位置決め治具6を位置決め案内板5に装着させる。第4の工程では、両面テープ3の低粘着性側の剥離紙を剥がし、基板位置決め治具6に配列形成された基板位置決め孔7にFPC基板1を挿入させ搬送板2の両面テープ3に固着させる。本実施例において、両面テープ3を構成する基材12の両面に塗付される粘着性

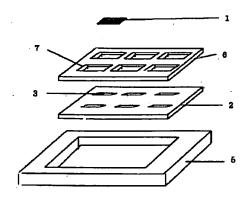
の異なる粘着剤として、低粘着性側は剥離性、再粘着性

があるシリコン系よりなる粘着剤が使用され、高粘着性 側は高い粘着力があるアクリル系よりなる粘着剤が使用

されている。

【0008】このようにして、粘着性の異なる粘着剤を 塗付した両面テープの高粘着性側を搬送板に複数列に貼 付することにより、両面テープは高い粘着力により搬送 板に確実に固着される。FPC基板はそれぞれ基板位置 決め孔7に位置決めされて搬送板に固着された両面テー プの低粘着性側に固着されるので、FPC基板を位置精 度良く搬送板に固着させることができる。剥離が容易で 再粘着可能な粘着剤に固着されたFPC基板を搬送板よ り剥離するときも、FPC基板を変形、損傷させること なく容易に剥離することができると共に両面テープの繰 り返し使用が可能となるるので、FPC基板の種別ごと に専用の搬送板を用意する必要もなく1種類の搬送板で 兼用させることができ、位置決めのための工数や両面テ ープなどの消耗品を節減できることから製造コストを大 幅に軽減させることができる。なお、両面テープに塗付 される粘着剤は、本実施例の粘着剤に限定されるもので はなく同性能を有するものであれば同様な効果が得ら れ、種々の組み合わせも可能である。

# 【図1】



# [0009]

【発明の効果】本発明による搬送板へのFPC基板固着 方法によれば、搬送板に粘着性の異なる粘着剤を塗付し た両面テープを複数列に貼付することにより、高粘着性 側は高い粘着力により搬送板に確実に固着される。FP C基板は基板位置決め治具により基板の平面と高さ方向 の位置精度も良く浮きもなく位置決めできるので、次工 程の印刷などの作業も精度良く容易になり、剥離性と再 粘着性の良い低粘着性側に固着されるので、FPC基板 を変形、損傷させることなく容易に剥離させることがで きると共に両面テープの再使用が可能となる。これによ り、FPC基板の種別ごとに専用の搬送板を用意する必 要もなく1種類で兼用させることができる。また、FP C基板に位置決め用の穴を設ける必要もなく、搬送板へ のFPC基板固着ができると共に両面テープの繰り返し 使用が可能となることから消耗品の節減と工数削減がで きるので、製造コストを大幅に低減させることができ

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による搬送板へのFPC基板固着方法の工程を示す説明図。

【図2】本発明の実施例における両面テープの構成図。 【符号の説明】

1 · · · · FPC基板

2 ・・・ 搬送板

3 ・・・ 両面テープ

3a・・・ 高粘着性側

3 b 低粘着性側

4 · · · · 剥離紙

5 ・・・ 位置決め案内板

6 ・・・ 基板位置決め治具

7 ・・・ 基板位置決め孔

8 · · · 基材

【図2】

